PROCESOS HABITUALES PARA LA REALIZACIÓN DEL MONTAJE DE SMD EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA

Lado Componentes	Lado Soldaduras	Procedimiento
Convencional + SMD		▪ Dispensar pasta estaño en los pads de los componentes SMD ▪ Inserción de los componentes SMD con Pick & Place ▪ Soldadura por refusión ▪ Montar y soldar el convencional de la forma habitual.
Convencional	SMD	▪ Dispensar punto cola en el centro geométrico del componente SMD ▪ Inserción de los componentes SMD con Pick & Place ▪ Curado del punto cola por horno ▪ Montar y soldar simultáneamente el convencional y el SMD
Convencional + SMD	SMD	▪ Dispensar punto cola en el centro geométrico del componente SMD lado soldadura ▪ Inserción de los componentes SMD con Pick & Place ▪ Curado del punto cola con el horno ▪ Dispensar pasta estaño en los pads de los componentes SMD lado componentes ▪ Inserción de los componentes SMD con Pick & Place ▪ Soldadura por refusión del SMD lado componentes ▪ Montar y soldar simultáneamente el convencional y el SMD lado sold.
Convencional + SMD	Convencional + SMD	▪ Totalmente igual al anterior, añadiendo al final del proceso el montaje y soldadura manual de los convencionales que están en la cara soldadura

RAMBLA MARINA, 456 7ª PLANTA
08907 L´HOSPITALET DE LL.
TEL. 93 337 21 46 / FAX 93 337 85

www.saemsl.com
MONTAJES ELECTRONICOS